

## Robo Bonder

Roboterunterstütztes 3D-Wirebondsystem

<b>Programm / Ausschreibung</b>	IWI 24/26, IWI 24/26, Basisprogramm Ausschreibung 2026	<b>Status</b>	laufend
<b>Projektstart</b>	22.12.2025	<b>Projektende</b>	31.12.2026
<b>Zeitraum</b>	2025 - 2026	<b>Projektlaufzeit</b>	13 Monate
<b>Keywords</b>			

### Projektbeschreibung

Das Ziel dieses Innovationsprojekts ist es einen funktionsfähigen 3D Dickdrahtbonder für beliebige Bauteilorientierungen zu entwickeln. Dazu wird ein Dickdraht-Bondkopf an einem 6-Achsroboter montiert.

### Projektpartner

- F&S BONDTEC Semiconductor GmbH